



산업부, 올해 소재부품 기술개발에 1조 1,780억원 투자

- '25년 소재부품기술개발사업 92개 과제 공고, 첨단산업 초격차 및
공급망 안정화 뒷받침

산업통상자원부(장관 안덕근, 이하 산업부)는 2.5.(수) '25년 소재부품기술개발사업을 공고하고 올해 소재부품기술개발에 전년(1조 1,410억)보다 3.2% 증가한 1조 1,780억원(계속 1조 890억, 신규 890억)을 투자한다고 밝혔다.

업종별로는 반도체(1,361억), 디스플레이(1,019억), 이차전지(1,009억), 바이오(1,028억) 등 첨단전략산업의 초격차 확보를 위한 소재부품 개발에 총 4,417억원을 투자하며, 이 중 '반도체 박막증착용 회속금속 소재 개발', '차세대 디스플레이 발광소재 개발', '전고체전지 고체 전해질 소재 개발', '급속 신생혈관 유도 바이오 잉크소재 개발' 등 26개 신규과제를 지원한다.

또한, 기계금속(3,053억), 자동차(890억), 화학(1,113억원) 등 주력산업의 고부가가치화 및 친환경 경쟁력 강화를 위한 소재 개발, 우주·항공(628억), 수소(200억) 등 미래 유망산업 선점을 위한 소재 개발에도 총 7,363억원을 투자한다. 특히, 정부가 지난 해 12월 발표한 “석유화학산업 경쟁력 제고 방안” 이행을 위한 ‘생분해 플라스틱 소재 개발’, ‘자원순환형 고분자 소재 및 응용기술 개발’ 등을 포함하여 66개 신규과제를 지원한다.

기능별로는 소부장 공급망 안정화를 위한 R&D를 지속 확대한다. '23년 176억원, '24년 766억원에 이어 올해는 1,312억원(+71.3%)을 투자해 185개 공급망안정품목의 대체소재 개발, 재자원화 등을 지원한다. 아울러, 소부장 분야의 민간투자 활성화를 위해 민간투자를 선(先)유치한 과제에 정부가 기술개발 자금을 대응 투자하는 투자연계형 기술개발에도 '24년 1,698억원에 이어 '25년은 3,027억원(+78%)으로 대폭 확대 지원한다.

산업부는 오늘(2.5) 공고된 소재부품기술개발사업 신규과제 수행기관을 4월까지(투자연계형 과제는 6월) 선정할 예정이며, 관련 기술개발 내용 및 양식은 한국산업기술기획평가원 R&D 디지털 플랫폼 (srome.keit.re.kr) 및 범부처 통합연구지원시스템 IRIS사이트(www.iris.go.kr)에서 확인할 수 있다.

나성화 산업공급망정책관은 “도전과 혁신의 소재부품기술개발을 통해 첨단산업의 초격차와 공급망 안정화를 뒷받침하는 한편, 인공지능(AI) 기반의 소재 디지털 개발방식을 접목해 신속한 기술개발을 도모하겠다”고 강조하였다.

담당 부서	산업공급망정책관 산업공급망정책과	책임자	과 장	김종주 (044-203-4910)
		담당자	사무관	전성우 (044-203-4915)



더 아픈 환자에게 양보해 주셔서 감사합니다
가벼운 증상은 동네 병·의원으로



참고

'25년 소재부품기술개발사업 투자계획 및 주요 신규과제

□ '25년 투자 계획

- 총 지원예산 : 1조 1,780억원(계속과제 1조 890억, 신규과제 890억)
- 업종별 지원계획 (단위 : 억원)

반도체	디스플레이	이차전지	바이오	기계금속	자동차	화학	전기전자	우주항공	수소	방산	기타	합계
1,361	1,019	1,009	1,028	3,053	890	1,113	906	628	200	83	490	11,780

* 지원 금액은 추후 과제별 선정평가, 단계평가 결과에 따라 변경될 수 있음

□ 주요 신규과제

구 분	주요 신규과제
패키지형 (소재·부품 동시 개발)	- 반도체 박막증착용 고순도 희소금속 전구체 생산 원료 제조 기술 개발 - 전계발광 양자점(EL-QD) 디스플레이 패널용 발광소재와 소자, 잉크젯 장비 개발 - 재자원화 시설내 생분해 처리가능 플라스틱 소재 및 재자원화 기술 개발 - 국제 환경 규제 대응 자원 순환형 고분자 소재 및 응용 기술 개발
이종기술융합형 (투자연계형)	- 4.5wt%H₂급 복합상 금속수소화물 기반 고효율 수소저장 부품화·모듈 개발 - 오가노이드 생체모방을 위한 금속 신생혈관 유도 바이오잉크소재 개발 - Micro LED Display를 위한 1억 UPH급 고생산성 전사 기술 개발 - 모바일 반도체 모듈 패키징을 위한 EMI 차폐 및 방열 소재/부품 기술 개발 - 전고체전지 상용화를 위한 황화물계 고체전해질 제조 공정 및 실증 기술 개발

□ 사업공고 홈페이지 및 문의처

- 상세 RFP/품목 및 관련양식은 한국산업기술기획평가원 R&D 디지털 플랫폼 (srome.keit.re.kr) 및 범부처통합연구지원시스템 IRIS사이트(www.iris.go.kr) 참조
- 온라인 시스템 접수 문의 : 범부처통합연구지원시스템 고객센터(☎ 1877-2041)
- 산업기술혁신사업 공통규정 문의 : R&D상담콜센터(☎ 1544-6633)
- 공고 문의 : 한국산업기술기획평가원 공급망산업실(☎ 053-718-8434, 8455, 8370, 8422, 8474, 8408, 8285)